证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-027

东芯半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名,注册会计师 2276 名,从业人员总数 9697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱锦梅	1998 年	1998 年	2008 年	2018 年
签字注册会计师	易小龙	2020 年	2021 年	2018 年	2022 年
质量控制复核人	张金华	2007 年	2007 年	2011 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:朱锦梅

时间	上市公司名称	职务
2019 年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	北京中电联环保股份有限公司	签字合伙人
2020 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021 年	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2020 年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	辽宁紫竹高科装备股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京实力电传文化发展股份有限公司	复核合伙人
2020 年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年	天津东方海川门窗幕墙股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	河北神玥软件科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京中科金财科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	山西博奥检测股份有限公司	复核合伙人
2020 年	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2020 年	南风化工集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2019 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021 年	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:易小龙

时间	上市公司名称	职务
2021 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张金华

时间	上市公司名称	职务
2019 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2019 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2019 年	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2019 年	山西博奥检测股份有限公司	签字合伙人
2019 年	辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	北京中科金财科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	北京实力电传文化发展股份有限公司	签字合伙人
2020 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳电通纬创微电子股份有限公司	签字合伙人
2021 年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021 年	福建瑞聚信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	福建瑞恒信息科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	北京中电联环保股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2021 年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020 年	长航凤凰股份有限公司	复核合伙人
2021 年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021 年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2020-2021 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计费用定价原则

公司 2021 年度的审计费用为人民币 95 万元。2022 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,独立、客观、公正地对公司 2021 年度的财务报表的有效性发表意见,真实反映了公司的财务状况和经营成果,表现了良好的职业操守和业务素质。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2021 年度会计报表审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十六次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-028

东芯半导体股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2021 年度募集资金存放与使用情况作出如下说明:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3558 号),并经上海证券交易所同意,公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 30.18 元,募集资金总额为人民币 333,677.44 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 7 日到位,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号《验资报告》。

(二)本年度募集资金实际使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
实际募集资金到位金额	A	308,581.64
减:审计验资费、律师费等发行费用	B	2,223.48
募集资金净额	C=A-B	306,358.16
加:利息收入扣减手续费净额	D	154.24
减:补充流动资金	E	29,415.00
结余募集资金余额	F=C+D-E	277,097.40
实际结余募集资金余额	G	279,320.88
差异	H=F-G	-2,223.48

说明:差异系未置换的审计验资费、律师费、发行手续费等发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,公司对于募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司苏州分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"监管协议")。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

金额单位:人民币元

开户行	账号	期末余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	633831543	2,314,714,409.38
中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行	1001242729300789239	80,862,659.25
华夏银行股份有限公司苏州分行	12462000000537642	397,631,684.80
合计		2,793,208,753.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入金额为 6,442.82 万元,本年度公司尚未进行置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2022 年 1 月 4 日,公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 69,300.00 万元用于永久补充流动资金。截止本报告日,公司实际用于永久补充补充流动资金的超额募集资金金额为 69,300.00 万元。

2、2022 年 1 月 4 日,公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 30.64 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。该议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。截止本报告日,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 207,547.78 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,东芯股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了东芯股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至 2021 年 12 月 31 日,东芯股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东芯股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:1、募集资金使用情况对照表

东芯半导体股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:东芯半导体股份有限公司 2021 年度

单位:人民币万元

募集资金总额		306,358.16			本年度投入募集资金总额							29,415.00
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额							29,415.00
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1xnm 闪存产品研发及产业化项目		23,110.68	23,110.68	23,110.68			-23,110.68		2024/6/30	不适用	不适用	否
车规级闪存产品研发及产业化项目		16,633.84	16,633.84	16,633.84			-16,633.84		2024/6/30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		5,840.48	5,840.48	5,840.48			-5,840.48		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		29,415.00	29,415.00	29,415.00	29,415.00	29,415.00		100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		75,000.00	75,000.00	75,000.00	29,415.00	29,415.00	-45,585.00					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目截至 2021 年 12 月 31 日先期投入金额 6,442.82 万元,公司尚未进行置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金截至 2021 年 12 月 31 日结余 277,097.40 万元,系尚未支付的募投项目投资额。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-029

东芯半导体股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果,在 2021 年度薪酬基础上进行浮动,不再另行领取董事津贴;

2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴;

3、公司独立董事 2022 年度的津贴标准与 2021 年度保持一致,均为人民币税前 10 万元/年。

(二)监事薪酬方案

1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果,在 2021 年度薪酬基础上进行浮动,不再另行领取监事津贴;

2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员,其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果,在 2021 年度薪酬基础上进行浮动。

(四)其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

三、独立董事意见

公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本公告中涉及的 2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-031

东芯半导体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定,东芯半导体股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3558 号文)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 30.18 元,募集资金总额为人民币 333,677.44 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 7 日到位,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	核准/备案号
1	1xnm 闪存产品研发及产业化项目	23,110.68	23,110.68	2020-310118-65-03-007307
2	车规级闪存产品研发及产业化项目	16,633.84	16,633.84	2020-310118-65-03-007313
3	研发中心建设项目	5,840.48	5,840.48	2020-310118-65-03-007308
4	补充流动资金项目	29,415.00	29,415.00	
合计		75,000.00	75,000.00	

本次募集资金将全部用于上述项目,项目投资将在建设期内按各自建设投资进度分阶段投入,如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况先行投入,并在募集资金到位后按照规定予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止 2021 年 12 月 31 日,公司以自筹资金已投入募投项目的金额为 6,442.82 万元,具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	自有资金预先投入金额(万元)	本次置换金额(万元)
1	1xnm 闪存产品研发及产业化项目	23,110.68	2,952.97	2,952.97
2	车规级闪存产品研发及产业化项目	16,633.84	2,787.09	2,787.09
3	研发中心建设项目	5,840.48	702.76	702.76
4	补充流动资金项目	29,415.00		
合计		75,000.00	6,442.82	6,442.82

2、自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计金额(不含增值税)为 273,192,873.81 元,其中保荐承销费 250,958,082.94 元(不含增值税)已在募集资金中扣除,其他发行费用 22,234,790.87 元(不含增值税)。截止 2021 年 12 月 31 日,公司已用自筹资金承担的发行费用金额为 22,234,790.87 元(不含增值税)。

四、相关审议程序

2022 年 4 月 21 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,442.82 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,223.48 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法规要求。

五、专项意见说明

(一)独立意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由立信会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。

(四)会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的《东芯半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定,在所有重大方面如实反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

公司代码:688110 公司简称:东芯股份

东芯半导体股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股分派现金股利 1.80 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 442,249,758.00 股,以此计算预计分派现金红利 79,604,956.44 元(含税),占公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润的 30.41%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	东芯股份	688110	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蒋雨舟	黄沈幪
办公地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5	上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5
电话	021-61369022	021-61369022
电子信箱	contact@dosilicon.com	contact@dosilicon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是大陆领先的存储芯片设计公司,聚焦于中小容量存储芯片的研发、设计和销售,是大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等主要存储芯片完整解决方案的公司。凭借强大的研发能力和稳定的供应链体系,产品已进入国内外众多知名客户,广泛应用于 5G 通信、物联网终端、消费电子、工业和汽车电子产品等领域。

自成立以来,公司即致力于实现本土存储芯片的技术突破,通过统一底层设计、功能性可变式的研发架构,构建了强大的设计电路图及封装测试的数据库,实现了芯片设计、制造工艺、芯片设计、封装测试等环节全流程的掌控能力,并拥有完全自主知识产权。公司设计研发并量产的 24nm NAND、48nm NOR 均为大陆目前领先的 NAND、NOR 工艺制程。

公司立足中国、面向全球,深耕全球最大的存储芯片应用市场,精准感知瞬息万变的市场动向,紧跟存储芯片国产化浪潮,凭借从芯片、应用电路到系统平台等全方位的技术储备,迅速响应客户个性化需求,针对性地提供包含 NAND、NOR、DRAM 的存储芯片完整解决方案。经过多年的经验积累和技术升级,公司打造了以低功耗、高可靠性为特点的多品类存储芯片产品,凭借在工艺制程及性能等方面出色的表现,公司产品不仅在高通、博通、联发科、紫光展锐、中兴微、瑞芯微、北京君正、恒玄科技等多家知名平台厂商获得认证,同时已进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等国内外知名客户的供应链体系,被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。2、主要产品或服务

公司的主要产品为非易失性存储芯片 NAND Flash、NOR Flash;易失性存储芯片 DRAM 以及衍生产品 MCP,各类产品具体情况如下:

(1)NAND Flash

NAND Flash 是通用型非易失性存储芯片的一种,其存储阵列是由存储单元通过串联方式连接而成,以"页"为单位进行读写操作,以"块"为单位进行擦除操作,因此具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点。

公司聚焦平面型 SLC NAND Flash 的设计与研发,主要产品采用浮栅型工艺结构,存储容量覆盖 1Gb 至 32Gb,可灵活选择 SPI 或 PPI 类型接口,搭配 3.3V/1.8V 两种电压,可满足客户在不同应用领域及应用场景的需求。公司的 SLC NAND Flash 产品主要用于支持 Linux、RTOS 等应用系统代码的存储和运行,实现数据的存储及快速改写,被广泛应用于如 5G 通讯模块和集成度要求较高的终端系统运行模块。

公司 NAND Flash 产品核心技术优势明显,尤其是 SPI NAND Flash,公司采用了业内领先的单芯片集成技术,将存储阵列、逻辑电路与接口模块统一集成在同一芯片内,有效节约了芯片面积,降低了产品成本,提高了公司产品的市场竞争力。公司产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定,不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过 10 万次,同时可在-40℃到 105℃的极端环境下保持数据有效性长达 10 年,产品可靠性逐步从工业级标准向车规级标准迈进。

公司的 NAND Flash 凭借产品品类丰富、功耗低、可靠性高等特点,被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备及移动终端等领域,获得了联发科、瑞芯微、中兴微、博通等行业内主流平台厂商的验证认可,被主要应用于 5G 通讯、企业级网关、网络智能监控、数字录像机、数字机顶盒和智能手环等终端产品。使用公司产品的终端知名客户包括中兴通讯、烽火通信、海康威视、大华股份、创维数字、航天信息等。

(2)NOR Flash

NOR Flash 是一类通用型的非易失性存储芯片,其存储阵列是各存储单元通过并联方式连接组成,在实现按位快速随机读取数据的同时,允许系统直接从存储单元中读取代码执行,因此具有芯片内执行、读取速度快等特点,通常被用于存储相关数据和代码程序,来满足快速启动应用系统的需求,普遍应用于可穿戴设备、移动终端等领域。

公司自主设计的 SPI NOR Flash 存储容量覆盖 2Mb 至 256Mb,并支持多种数据传输模式,公司的产品主要被用于存储代码程序,例如在功能手机中用于存放通信数据交换时的启动程序;在智能手机的摄像头模组中用于存放校正图像分辨率的指令代码;在蓝牙无线耳机中存放启动时的引导程序,目前公司已经为三星电子、LG、传音控股、歌尔股份等中外知名终端客户提供产品。

(3)DRAM

DRAM 是市场上主要的易失性存储产品之一,通过利用电容内存储电荷的有无来代表二进制比特(bit)来实现数据存储。DRAM 具有读写速度快的特点,常被用于系统硬件的运行内存,对系统中的指令和数据进行处理。

公司研发的 DDR3 系列是可以传输双倍数据流的 DRAM 产品,具有高带宽、低延时等特点,在通讯设备、移动终端等领域应用广泛;公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求,自主研发的 LPDDR 系列产品具有低功耗、高传输速度等特点,适合在智能终端、可穿戴设备等产品中使用。目前使用公司 DRAM 系列产品的国际知名客户包括 LG、瑞萨、索喜、惠尔丰、伟创力等。

(4)MCP

MCP 是通过将闪存芯片与 DRAM 进行合封的产品,以共同实现存储与数据处理功能,节约空间的同时提高存储密度,目前主要用于空间受限的电子产品,被应用于移动终端、通讯设备领域。

公司的 MCP 产品集成了自主研发的闪存芯片与 DRAM,凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科的 4G 模块平台通过认证,被应用于功能手机、MIFI、网络电话、POS 机等产品,获得了 TCL 科技、日海智能、捷普等知名企业的认可。

(5)技术服务

公司拥有自主完整的知识产权,凭借积淀多年的存储芯片设计经验和资深的研发团队,可根据客户的特定需求提供 NAND、NOR、DRAM 等特定存储芯片定制化的设计服务和整体解决方案,帮助客户降低产品开发时间和成本,提高了产品开发效率。

在为客户进行定制化的设计过程中,公司不断了解市场对产品功能需求,接收客户对终端产品的反馈,反复验证和打磨已有的技术,建立了"研发-转化-创新"的技术发展循环,进一步增强技术能力。

(二) 主要经营模式

集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。从经营模式来看,主要分为 IDM 模式(企业业务覆盖集成电路的设计、制造、封装和测试的所有环节)和 Fabless 模式(无晶圆生产线集成电路设计模式,即企业只进行集成电路的设计和销售,将制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成)两种。公司作为 IC 设计企业,自成立以来一直采取 Fabless 模式,专注于集成电路设计及最终销售和售后服务环节,将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。

从集成电路整体产业链来看,集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节,成品销售则是控制销售渠道、客户资源及品牌的售后服务环节,均在产业链中具有核心及主导作用,是 IC 设计行业原始创新的体现和价值创造的源泉。公司专注于研发设计和产品销售环节,在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。

从销售模式看,公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下,公司与客户直接签署销售合同(订单)并发货;经销模式下,公司与经销商签署经销商协议和销售合同,由公司向经销商发货,再由经销商向终端客户销售。在此模式下,采取卖断式销售。经销模式作为集成电路设计行业较为常见的销售模式,有效提高了行业内企业的运作效率,助推企业快速发展。在经销模式下,作为上下游产业的纽带,经销商在高效开拓市场、提供客户维护、加快资金流转等方面发挥了重要作用。直销模式下,缩短了公司的销售流程,企业与终端客户能保持紧密联系,通过与终端客户的交流,有助于提供感知行业变化趋势,及时把握市场需求从而开展产品技术创新与改进,不断推出满足市场的优质产品。公司依靠产品稳定的性能和可靠的质量,在行业内获得了良好的品牌知名度,吸引了知名客户直接向公司采购产品。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司作为本土存储芯片设计行业,隶属集成电路行业,伴随着下游电子信息产业持续高速发展,在国家政策的支持下,特别是国家科技重大专项的实施,我国集成电路产业实现了快速发展。其中集成电路设计行业处于产业链的上游位置,主要从事芯片的研发设计。作为集成电路行业中对科研水平、研发实力要求较高的部分,集成电路设计行业需要不断进行创新研发、技术迭代来推动行业技术的迭代发展,同时芯片设计水平对芯片产品的成本、性能、功能有较大影响,因此集成电路设计行业研发能力的强弱也可以反映一个国家在芯片领域的地位与实力。

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期,正全力追赶世界先进水平,也正处于快速发展阶段。同时也随着集成电路行业规模快速扩张,产业间竞争加剧,促使行业分工不断细化,目前集成电路行业主要可分为集成电路设计、晶圆制造、封装测试等子行业。

同时也受益于 5G 通讯、大数据、物联网、可穿戴设备、云计算和新能源等新兴领域的不断发展,应用场景的不断扩展,以及新兴技术如人工智能、物联网和虚拟现实的出新,集成电路产品的市场需求也在不断扩大。

NAND Flash 方面,根据 TrendForce 数据统计公布,总结 2021 年 NAND Flash 市场销售表现,尽管自下半年开始有转弱迹象,但全年受惠于疫情所带动的远距服务与云端需求,营收表现仍较 2020 年显著增长,产业营收达 686 亿美元,年增 21.1%。日益发展的 5G 通讯、物联网、汽车电子等新兴领域对高可靠性中小容量 NAND Flash 需求增加。

NOR Flash 方面,近年来,随着应用场景的不断扩展,如物联网的普及、5G 基站建设、汽车智能化、可穿戴设备和工业控制等新兴应用的不断发展与增多,根据 CINNO Research 的数据,NOR Flash 的市场需求稳定增长,从 2017 年的 24 亿美元,增长至 2019 年的 28 亿美元左右。预期在 2022 年市场规模会增长到 37 亿美元。NOR Flash 产品将有望迎来更多增量需求。

也可以发现近年来,三星、海力士、美光等行业的头部企业占据了存储芯片的大部分市场份额,尤其在 DRAM 和 NAND 市场中更是几乎处于垄断地位。行业龙头均从事集成电路行业较早,在几十年的发展中积累了技术开发经验,建立了完备的人才培养体系,其技术与人才壁垒使得后来者很难在短时间内赶超;头部企业通过技术优势转化为市场优势,独占了大部分市场份额,为公司带来了丰厚的资金回报,得以支撑其高昂的研发费用和指数式增长的产能投资,进一步促进技术创新和人才储备,不断产生正向的激励循环,推动了行业资源向龙头集中的现象,形成了"强者愈强"的产业格局。

本土芯片企业紧抓新机遇,汽车电子、人工智能、5G、物联网等新兴领域将是现阶段推动集成电路技术快速发展的重要驱动力。预计未来几年在上述领域需求的刺激下,5G 基站、智能家居、可穿戴设备等新兴应用将持续涌现,对存储芯片的功耗、安全性、传输速率、体积和成本会有更高的要求,同时安全技术、运算能力、视觉影像的处理能力、大数据支撑平台以及显示技术、感知技术、无线连接技术等均是未来物联网、人工智能等产业发展和产品升级的关键,也会成为未来集成电路设计及相关应用研发的方向和重点。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)大陆领先,产品覆盖通讯安防领域头部客户

公司是大陆领先的存储芯片设计公司,是大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等主要存储芯片完整解决方案的公司。公司设计研发并量产的 24nm NAND、48nm NOR 均为大陆目前领先的 NAND、NOR 工艺制程,实现了大陆闪存芯片技术的突破。凭借在工艺制程及性能等方面出色的表现,公司产品不仅在高通、博通、联发科、紫光展锐、中兴微、瑞芯微、北京君正、恒玄科技等多家知名平台厂商获得认证,同时已进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等国内外知名客户的供应链体系,被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。

(2)持续创新,技术持续引领大陆存储芯片行业

2021 年,SLC NAND 芯片在中芯国际 1x nm 工艺生产线上成功流片,这也代表着公司已拥有向 1x nm 制程进一步迈进的经验积累和技术储备,推进公司产品制程进一步升级,增加产品市场竞争力。公司基于与各工艺平台成功的开发经验,并结合市场需求反复调试和优化,陆续丰富了 SLC NAND 系列产品线,并在持续改良研发中获得更高的产品性能。

2021 年,公司持续加大在车规级产品的开发,SLC NAND 产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定,不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过 10 万次,同时可在-40℃到 105℃的极端环境下保持数据有效性长达 10 年,产品可靠性逐步从工业级标准向车规级标准迈进。

公司通过持续创新,不断更新迭代产品,持续微缩制程及提高良率,引领公司产品由消费级、工业级向车规级演进,技术持续引领大陆存储芯片产业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)工艺不断精进,设计制造环节加深产业联动

集成电路制程的先进与否直接决定了存储芯片的成本和性能。以 NAND Flash 产品为例,近些年来,随着集成电路技术不断推进,行业领跑企业凭借 IDM 模式下设计部门和制造部门的默契配合,已经完成了 1x nm 工艺存储芯片量产,降低了存储产品的单位成本,拓宽了存储产品的使用场景。在 Fabless 模式下,存储芯片设计公司为了提升产品制程,缩小与头部企业的差距,将会继续加深与晶圆代工厂的合作发展,双方共享研发能力、整合技术资源,形成标准的制造工艺流程,减少工艺对接的时间成本,提升存储芯片的流片良率与产品性能。

(2)行业规模巨大,差异化竞争形成细分市场机遇

近年来,存储芯片一直都是集成电路市场份额占比较大的类别产品,2019 年存储芯片占全球集成电路市场规模的比例高达 31.93%,成为全球集成电路市场销售份额占比最高的分支。

虽然存储芯片市场规模巨大,但整个市场呈现分化现象。三星电子、海力士、美光科技、铠侠等企业提供全面的存储产品,近年来专注研发大容量、高性能存储芯片,不断推进先进存储技术并凭借技术优势获取较高市场份额。行业其他企业由于各家处于的发展阶段不同,在以领先企业为目标进行技术赶超的同时,结合自身技术特点和市场需求,专注于成熟产品的细分市场并实现填补和替代效应,与行业领先企业形成差异化竞争,迎来了新的发展机遇。

(3)下游需求强劲,新兴行业崛起加速产业发展

国内集成电路产业快速发展,终端市场需求持续攀升,存储芯片作为消费电子、通讯设备、物联网等领域不可替代的功能器件,其在国内的市场销售规模亦呈现稳步上升的趋势。近年来随着科技创新技术的不断成熟和应用,5G 通讯、汽车电子、可穿戴设备等新兴行业迎来快速发展,5G 基站、ADAS、智能电子产品等终端产品持续涌现,其对文件处理、图像感知、代码执行等数据存储和执行能力的要求也在不断提升,因此存储芯片的数量、性能和成本未来将会有持续强劲的需求和不断迭代的要求。

新兴产业及新兴市场将形成对存储芯片旺盛的增量需求,存储芯片作为这些新应用中不可或缺的重要组成部分,将直接受益于日益增长的行业浪潮。

(4)紧跟国家战略,国产替代推动行业发展

2014 年国务院首次发布集成电路的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》,突出企业的主体地位,以需求为导向,以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力,突破集成电路关键装备和材料瓶颈,推动产业整体提升,实现跨越式发展。随后我国各级政府出台了一系列政策,从资金支持、补贴奖励等方面吸引优秀企业、人才落户,进一步凸显国家对集成电路产业的重视,以打破国外在集成电路设计、制造等关键领域的垄断。

叠加近年中美在高科技领域间的贸易摩擦,由于国外厂商对国内市场的供给缩紧,国内集成电路市场需求急需具有先进产品技术和优质服务能力的国内企业填补,尤其是国内规模较大的终端品牌商为了保证经营稳定,加快本土供应链体系建设,进一步推动了我国存储芯片国产替代的进程。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,178,428,032.66	758,774,884.27	450.68	705,629,210.58
归属于上市公司股东的净资产	3,820,252,676.53	501,404,956.99	661.91	403,914,689.34
营业收入	1,134,281,270.31	784,307,913.62	44.62	513,608,750.78
归属于上市公司股东的净利润	261,796,151.50	19,533,095.76	1,240.27	-63,837,288.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,266,140.57	17,553,189.22	1,354.24	-63,432,228.08
经营活动产生的现金流量净额	117,522,087.87	228,390,811.55	-48.54	-229,572,470.82
加权平均净资产收益率(%)	29.49	4.17	增加 25.32 个百分点	-20.26
基本每股收益(元/股)	0.77	0.06	1,183.33	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.06	1,183.33	-0.22
研发投入占营业收入的比例(%)	6.60	6.06	增加 0.54 个百分点	9.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	188,371,953.33	266,363,765.65	330,369,799.60	349,175,751.73
归属于上市公司股东的净利润	34,745,096.50	45,145,691.41	88,210,396.85	93,694,966.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,895,154.76	45,075,207.86	88,024,980.97	93,270,796.98
经营活动产生的现金流量净额	31,860,283.95	24,599,659.44	-23,005,668.46	84,067,812.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,582
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,236
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
东方恒信资本控股集团有限公司	0	143,213,025	32.38	143,213,025	143,213,025	无	0	境内非国有法人
齐亮	0	28,070,175	6.35	28,070,175	28,070,175	无	0	境内自然人
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	0	28,070,175	6.35	28,070,175	28,070,175	无	0	其他
苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	22,500,000	5.09	22,500,000	22,500,000	无	0	其他
杭州中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	19,478,096	4.40	19,478,096	19,478,096	无	0	其他
哈勃科技投资有限公司	0	13,267,493	3.00	13,267,493	13,267,493	无	0	境内非国有法人
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	10,526,316	2.38	10,526,316	10,526,316	无	0	其他
董玮	0	8,771,930	1.98	8,771,930	8,771,930	无	0	境内自然人
深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙)	0	8,771,930	1.98	8,771,930	8,771,930	无	0	其他
上海小橡创业投资合伙企业(有限合伙)	0	7,017,544	1.59	7,017,544	7,017,544	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信资本控股集团有限公司的控股子公司;董玮为深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙)的实际控制人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

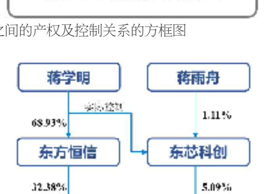
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

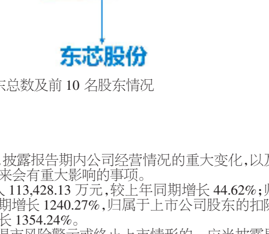
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 113,428.13 万元,较上年同期增长 44.62%;归属于上市公司股东的净利润 26,179.62 万元,较上年同期增长 1240.27%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,526.61 万元,较上年同期增长 1354.24%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用